

天津金海通半导体设备股份有限公司关于全资子公司投资建设上海澜博半导体设备制造中心建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海澜博半导体设备制造中心建设项目（以下简称“新建半导体设备制造中心”、“项目”）。
- 投资金额：不超过4亿元；
- 已履行的审议程序：本次投资已经天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年2月1日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过。本公司在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险提示：

1. 投资项目的审批风险：本次投资项目需获得政府相关部门关于土地使用权、环评影响评估等事项的审批或备案，若公司未能按期完成上述审批或备案，可能导致项目建设进度不及预期，进而对项目投资效果产生不利影响。

2. 投资项目实施进度可能不及预期的风险：公司已对本次投资项目的实施与管理进行了合理规划和预计，但项目进度安排是基于目前市场及预期判断的。若项目建设过程中出现意外情况，可能导致工期延期，因此存在项目实施进度不及预期的风险。

3. 投资项目无法达到预期收益的风险：本次投资项目的可行性分析及预计经济效益，均是基于当前宏观经济环境、产业政策、市场需求关系、行业技术水平等作出的合理预测，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的承诺。由于项目实施周期较长，如遇市场环境变化、行业政策调整，不可抗力等因素的影响，未来经营效果的实现存在一定不确定性。

4. 投资项目资金筹措风险：本次项目总投资额不超过人民币4亿元，资金将根据项目实施进度通过自有资金和银行贷款等方式分期筹措。若公司未来经营性现金流状况不及预期，或融资环境发生变化，项目资金的按时、足额投入存在一定不确定性。

（一）对外投资概述

1. 本次交易概况

基于公司的发展战略及业务布局，公司拟在上海青浦区华新镇投资建设“上海澜博半导体设备制造中心项目”。项目总投资不超过4亿元，建设集生产、研发与综合办公一体的生产运营中心。

2. 本次交易的交易要素

（一）投资主体

（二）投资标的

（三）投资金额

（四）投资期限

（五）投资方式

（六）资金来源

（七）投资进度

（八）投资目的

（九）投资风险

（十）投资决策

（十一）其他

（十二）投资协议

（十三）投资完成后的后续安排

（十四）投资完成后的后续安排

（十五）投资完成后的后续安排

（十六）投资完成后的后续安排

（十七）投资完成后的后续安排

（十八）投资完成后的后续安排

（十九）投资完成后的后续安排

（二十）投资完成后的后续安排

（二十一）投资完成后的后续安排

（二十二）投资完成后的后续安排

（二十三）投资完成后的后续安排

（二十四）投资完成后的后续安排

（二十五）投资完成后的后续安排

（二十六）投资完成后的后续安排

（二十七）投资完成后的后续安排

（二十八）投资完成后的后续安排

（二十九）投资完成后的后续安排

（三十）投资完成后的后续安排

（三十）投资完成后的后续安排